

7 本国产品标准证明文件（实质性格式）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. S8700-6, 生产厂为华为技术有限公司, 厂址为深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼。S8700-6 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。S8700-6 的芯片在中国境内生产。S8700-6 的硬件设计、制造与核心软件配置在中国境内完成。

2. LSG7X24SX1E0, 生产厂为华为技术有限公司, 厂址为深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼。LSG7X24SX1E0 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。LSG7X24SX1E0 的芯片在中国境内生产。LSG7X24SX1E0 的硬件设计、制造与核心软件配置在中国境内完成。

3. SFP-1000BaseT, 生产厂为华为技术有限公司, 厂址为深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼。SFP-1000BaseT 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。SFP-1000BaseT 的芯片在中国境内生产。SFP-1000BaseT 的硬件设计、制造与核心软件配置在中国境内完成。

4. S8700-10, 生产厂为华为技术有限公司, 厂址为深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼。S8700-10 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。S8700-10 的软件在中国境内生产。S8700-10 的软件开发及配置在中国境内完成。

5. LSG7X48SX1E0, 生产厂为华为技术有限公司, 厂址为深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼。LSG7X48SX1E0 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。LSG7X48SX1E0 的芯片在中国境内生产。LSG7X48SX1E0 的硬件设计、制造与核心软件配置在中国境内完成。

6. LSG7C16HX1E0, 生产厂为华为技术有限公司, 厂址为深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼。LSG7C16HX1E0 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。LSG7C16HX1E0 的芯片在中国境内生产。LSG7C16HX1E0 的硬件设计、制造与核心软件配置在中国境内完成。

7. S6730-H24X6C-V2, 生产厂为华为技术有限公司, 厂址为深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼。S6730-H24X6C-V2 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。S6730-H24X6C-V2 的芯片在中国境内生产。S6730-H24X6C-V2 的硬件设计、制造与核心软件配置在中国境内完成。本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：北京丰科瑞智信息技术有限公司

日期：2026年7月20日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

